

アテムコ社の導電性耐熱有機接着剤

アテムコボンド 556-HT-HC

アテムコ社が開発した「アテムコボンド 556-HT-HC」は銀の粒子を高濃度に充填した低抵抗型のエポキシ系導電性耐熱接着剤です。マイクロチップの接合や半導体のダイ接着、その他の電気電子部品の組み立てに活用されています。耐熱上限は200℃です。

特性

「アテムコボンド 556-HT-SP」は高純度の銀粒子を含有したベース樹脂と硬化剤を混合して使用する2液型です。耐熱上限は持続200℃、断続250℃です。体積抵抗率は常温で<0.0001 ohm-cm、熱伝導性は2.2W/m²°K、引張せん断強度は1,700 psiです。

使い方

はじめに接着する面を十分に脱脂洗浄してください。
次に樹脂ベースBと硬化剤Aを重量比100:2でよく混ぜ合わせます。
ポットライフは約48時間です。
被着体に薄く塗り、貼り合わせ、93℃で2時間、または、121℃で1時間焼成して硬化させます。
硬化後の硬度はショアーDで90です。

荷姿

50グラム広口プラスチック容器入り。
(ベース液と硬化剤の総量。)

